

点胶式固晶无铅高温锡膏

1、适用.

此规格书适用于SMT-LED点胶式专用无铅锡膏.

2、产品特征.

NO	项目	品质规格	测试方法
1	外观	灰色均匀膏体	目视
2	气味	无刺激性气味	*
3	主要成分	Sn89.5Sb10Ni0.5松香系合成树脂助焊剂	*
4	比重	9.0~9.2	*
5	熔点	262℃	熔点分析仪
6	卤素含量	0.01±0.005 wt%(氯素换算值)	JIS-Z-3197, 加入无水乙醇, 溶解锡膏, 用硝酸银溶液滴定法测
7	粘度	150±20 Pa. s (20℃)	使用MALCOM粘度剂测定, 记录20℃, 10rpm的粘度值.
8	可焊性	润湿性好, 接合强度大	采用湿润平衡法原理或可焊性测试仪器.

*物质纯度.

根据化学分析以及原子吸光法或火花放射光谱法测定.

*成分表

产品成分	CAS编号	重量百分比	AGGIH TLV	OSHA PEL	单位
			TWA	TWA	
银	7440-22-4	2.65-2.75	0.15	0.05	mg/m3
锡	7440-31-5	85-88.5	2.00	2.00	mg/m3
铜	7440-50-8	0.445-0.45	NE	NE	-
松香	65997-05-9	4.0-6.0	NE	NE	-
表面活性剂	10035-10-5	2.0-3.0	NE	NE	-
活性剂	505-48-6	0.2-0.9	NE	NE	-
有机溶剂	107-21-1	4.0-5.0	NE	NE	-

*成品检查

NO	项目	检查标准	判定基准
1	外观	每批	*
2	组成	每批	*
3	卤素含量	每批	*
4	粘度	每批	*
5	可焊性	每批	*

3、包装.

包装以针筒为主, 每瓶20克

4、使用方法与注意事项.

*保存方式.

在冰箱里0℃至+5℃以内冰箱密封保存, 有效期3个月, 温度过高和过低对品质均有影响.

*使用方法.

A. 锡膏从冰箱中取出后, 在不拆开包装的情况下置于室温中“回温”2-4小时左右后再直接使用.

B. 锡膏点胶后, 应尽快完成元器件的贴装, 并过炉完成焊接, 避免因放置时间过长影响贴装效果.

建议使用8-11小时后换添锡膏. (注: 建议产品点胶后在2小时内进炉焊接!)

C. 调试回流焊温度(时速100-120cm/min)

注: 仅供参考(带盘过炉), 可根据参考参数进行调试合适焊锡的温度, 不同的机器与使用锡膏方法调试温度也不同!

温区	1	2	3	4	5	6	7	8
温度	245	296	325	345	315	230	215	195

D. 焊后残留物极少, 且颜色透明, 高绝缘阻抗, 不必清洗, 如客户需要清洗, 建议用乙醇或者异丙醇擦洗

E. 焊接好了的产品进行小批量推力测试, 若测试推力通过方可大量焊接, 如若推力不通过则需重新调试过炉温度.

*操作注意事项

仅限操作者使用, 作业时请佩戴口罩或安装抽气扇, 以防吸入过多的焊接时产生的气体, 操作完之后需洗手. 如接触皮肤请用乙醇或者异丙醇擦洗, 接触眼睛需要就近医院处理.

工厂: 东京都 大田区 城南岛2-3-7

电话: 03-3790-8911

传真: 03-3790-8917